

## 科技局副局长任晖带队调研协会企业

2013 年 5 月 21 日上午,市科技局副局长任晖带队到集成电路企业开展群众教育实践活动调研工作,先后走访了西安航天民芯科技有限公司、西安华芯半导体有限公司和西安市集成电路产业发展中心。

在企业调研中,任晖一行听取了企业的发展情况汇报,对企业提出的人才培养、计划项目申报、开展促进企业员工间交流活动等方面进行了深入交流,并给企业提供了解决问题的建议。在集成电路中心的座谈会上,大家主要围绕科技局重点工作的开展和团队建设方面进行了交流沟通。

通过本次群众路线教育实践活动调研,不仅深入了解了企业多方面的现状与需求,也对集成电路中心今后调整思路,为企业提供优质全面的服务奠定了基础。

## 李明远厅长到陕西电子信息集团考察调研

5 月 22 日上午,省科技厅厅长李明远一行到陕西省电子信息集团调研。陕西电子信息集团是省委、省政府根据“大集团引领、大项目支撑、集群化推进、园区化承载”工业发展战略,于 2007 年组建的我省重点大型企业集团,是陕西省发展电子信息产业、太阳能光伏和半导体照明产业的龙头企业,陕西省半导体行业协会常务理事单位,拥有一级企业 17 户。

李厅长听取了田盘龙董事长就集团科技创新工作做的专题报告,参观了集团公司展室,考察了集团下属的西安半导体产业园、烽火产业园、西京电子元器件产业基地等园区及相关企业生产现场,参观了国内领先、国际一流的电子元器件生产线、整机制造生产线及科研现场,了解了集团公司科技创新工作开展情况,对电子集团在军工电子、新兴产业等方面所做的工作和取得的成就表示肯定,并表示省科技厅将一如既往地支持电子集团的科研工作。计划处、高新处和产业处负责同志一同参加调研考察。

## 赵红专会见美光半导体西安公司总经理

6月20日，市委常委、高新区党工委书记赵红专会见美光半导体（西安）有限公司总经理朱文菊，高新区管委会副主任陈辉陪同会见。

赵红专表示，美光半导体公司落户西安高新区以来，发展势头一直很好。在优秀团队的带领下，美光半导体西安公司短时间内取得显著的成效，今年上半年业绩又取得突破性进展，未来前景十分看好。希望彼此共同努力，为高新区的发展贡献更多更大力量。高新区将继续发挥效率优先、服务至上的工作作风，做好服务、协调工作，全力以赴支持美光半导体西安公司在高新区的发展。

朱文菊表示，西安高新区的投资环境优越，高新区管委会服务效能高。在上扬的市场大环境下，美光半导体西安公司发展特别好，取得了很好的业绩。在人员培训、三期建设方面，美光半导体西安公司还需要高新区的进一步支持，希望能有更好更深入的合作。

## 771所为神十天宫交会对接全程护航

此次从神十飞天，到与天宫相拥，再到航天员的生命保障，中国航天科技集团公司九院771所，协会常务理事单位，为飞行任务研制了多种核心产品和设备，为交会对接任务的成功实施、保障航天员生命安全发挥了重要作用。

精确控制火箭入轨神舟十号飞入苍穹后，一个重要任务就是与天宫一号进行交会对接，而首要条件就是让两个航天器处于同一个轨道面，若轨道计算稍有差池，就会差之毫厘，失之千里。在此次神舟十号飞行任务中，771所研制生产的关键设备就是让火箭精确入轨的“大脑”。

打造与航天员通话的“立体声”。为确保飞船在上升、返回，特别是运行期间与地面的沟通交流，及时传送相关信息，771所为本次任务配套研制了相当于“立体声”系统的专用设备，确保航天通话正常，实现地面与舱内的无障碍沟通。

为航天员打造舒适环境。航天员要在太空中生存并进行科研实验等活动，首先必须有一个舒适安全的工作和生活环境，同时还要对航天员的身体状况进行有效监测，确保航天员各项生理状况正常。771所为神舟十号飞船研制的多种产品和装置，为确保航天员生命安全并顺利实施交会对接提供了保障。

## 科技局局长问向荣一行赴户县进行群众路线工作调研

6 月 2 日下午，西安市科技局问向荣局长、张丙周副巡视员带领农村处、计财处、交流处等相关人员赴户县开展群众路线实践活动调研。

问向荣一行与户县郭强副县长以及科技部门、沣京工业园管理部门同志座谈，详细了解园区建设进展情况、存在的实际困难以及下一步工作步骤。问向荣强调，一是园区建设要高起点规划，要与户县副中心城市要求相一致，充分论证，符合城镇化、工业化、信息化建设要求；二是做好土地供应和基础设施建设，加强配套服务，在符合大要求前提下加快进度，利用园区围墙、广告牌加大宣传，营造氛围；三是按照工作计划扎实有序推进其他各项工作，做好目标定位，加强各部门衔接协调，定期碰头，专题专议，明确职责和分工；四是沣京工业园建设要作为市科技局今后几年重点工作，分专人、专门处室负责联络协调，加大项目支持力度，利用政策杠杆支持园区建设。

来源：西安科技网

## 省工信厅领导调研高新区软件产业发展

6 月 7 日，省工信厅副厅长许蒲生一行来到高新区，调研高新区软件及信息服务产业发展情况，高新区管委会副巡视员李亚红陪同。

李亚红对多年来省工信厅对高新区软件及信息服务产业的关心和支持表示感谢，并介绍了高新区软件及信息服务产业发展的基本情况，产业空间布局、产业结构、产业特点、重点企业、服务体系、发展定位和总体目标，以及面临的挑战和问题，希望工信厅领导多提建议，支持加快产业的聚集和发展。

许蒲生表示，软件园在大力推进 14 平方公里的软件新城建设，发挥行业应用软件研发、嵌入式软件研发、集成电路设计以及信息技术服务外包等产业优势，以“云计算”方式推动移动互联网、物联网、大数据产业发展的过程中，坚持高端研发、做好服务外包并关注中小企业发展，希望进一步明晰产业发展方向，形成鲜明的产业特色，促进产业做大做强。

来源：开发区报道

## 安建利会见比亚迪总裁王传福

5月17日，高新区党工委副书记、管委会主任安建利会见了比亚迪股份有限公司总裁王传福一行。管委会副主任杨仁华等一同会见。

安建利对王传福的到来表示欢迎。他说，比亚迪在IT、汽车、新能源等领域具有很强的发展优势，自从2003年进驻西安高新区以来，取得了长足发展，不仅带动了西安汽车工业发展，而且为西安经济发展、就业等方面做出了突出贡献。安建利表示，西安高新区高度重视与比亚迪的合作，希望比亚迪继续发挥在技术研发、客户网络等方面的优势，进一步提高产品竞争力，争取更好的发展前景；同时，也希望比亚迪公司进一步加快汽车二厂的建设步伐，早日建成投产。

王传福对西安高新区长期以来的大力支持表示感谢。他说，比亚迪将把电动大巴车、电动出租车等新能源汽车作为在西安发展的主攻方向之一，同时将在西安投产更多的新车型，并将不断提高产品质量，以及市场知名度，为西安经济发展做出积极贡献。

来源：开发区报道

## 西安光伏企业“走出去”研讨会召开

6月14日，由高新区发展改革和商务局组织的西安光伏企业“走出去”研讨会召开。西安市商务局相关负责人，陕西电子信息集团、陕西光伏、黄河光伏、烽火光伏、特变电工等光伏企业代表参加了研讨会。

研讨会上，市商务局相关负责人介绍了光伏企业欧盟反倾销背景及国内对此采取的措施。欧盟委员会于当地时间6月4日公布对中国光伏产品反倾销调查初裁结果，从6月6日开始，欧盟将对产自中国的太阳能电池板和关键器件，征收11.8%的临时反倾销税。如果中欧双方未能在2个月后（8月6日）达成协议，到今年年底，反倾销税的税率将上升到47.6%。

针对这一情况，我国迅速应对，并采取了相应措施，国内光伏企业通过中国机电商会积极应诉。市商务局相关负责人表示，发展是企业永恒的主题，在困难时期，西安光伏企业更应坚定发展信心，紧抓国内、国际市场，除欧美等市场外着眼拉美、非洲等新兴市场，龙头企业要充分依托陕西光伏产业链完备这一优势，通过投资等方式“走出去”带动企业发展。

来源：开发区报道

## 马建堂调研三星项目进展情况

5 月 20 日，国家统计局局长马建堂来到西安高新区，调研三星项目进展情况。陕西省统计局局长丁云翔，西安市副市长黄海清，市统计局局长李利民等陪同调研，高新区领导杨明瑞、杨念田参加调研。

在三星电子项目指挥部规划展室，杨明瑞介绍了三星项目落户及规划建设情况。他说，属于战略性新兴产业高科技项目的三星存储芯片项目，从 2012 年 4 月 10 日签约到 2012 年 9 月 12 日在西安高新区开工奠基，历时仅五个月，创造了“西安效率”和“陕西速度”，在国内外都引起强烈的反响。为确保三星项目的防洪安全，高新区还启动了洩河治理工程；同时，为保证三星及周边企业运输高效快捷，修建了一条长 5.6 公里的快速干道。

随后，马建堂一行来到三星项目主厂区，各配套项目都在有条不紊地进行中，三星项目规范的现场管理，三星项目安全培训体验馆等，都引起他们的高度称赞。在现场，马建堂听取了三星项目负责人对项目相关情况的汇报，看到现场大规模工程建设已全面展开，并按照预期进度向前推进，马建堂表示，非常期待三星项目建成投产，服务于西安及高新区经济发展。

来源：开发区报道

## 韩总统朴槿惠视察西安三星工厂

韩国总统朴槿惠 6 月 30 日参观了三星电子项目和秦始皇兵马俑博物馆，朴槿惠表示，西安是文明古都，也是西部大开发的核心点，来到西安就可以看到中国的过去、现在和未来。

上午，韩国总统朴槿惠在省长娄勤俭的陪同下，首先来到了位于西安高新区的三星电子项目工地，了解工程进展情况。当得知目前项目进展顺利，预计今年年底一期将正式建成后，朴槿惠表示随着三星项目的顺利实施，在企业发展的同时，也给个人提供了很好的发展空间。今后将会有越来越多的韩国企业来陕投资，韩国也将加大对中国西部大开发的支持。

下午三点四十分，韩国总统朴槿惠结束了在我省的访问，乘专机返回韩国。副省长王莉霞、西安市市长董军等分别陪同参观。

来源：西部网

## 三星电子快速干道今年 10 月将实现建成通车

4月30日,三星电子快速干道 K3+402 高架桥最后一块梁顺利就位,这标志着三星电子快速干道项目全线架梁任务圆满完成。

三星电子快速干道工程起点位于沣河以东左家堡村,设互通式立交与京昆高速相接,向东南侧设线,在李家桥村跨沣惠渠至黑牛坡,由北安丰与南三角之间经过,跨西户路至童家寨以南,终点位于西安高新技术产业开发区三星电子产业基地综合保税区 1 号卡口外,与三星电子厂区道路相接。

快速干道全线长约 5.6 公里。工程按照四车道城市快速路标准建设,设计速度 100 公里/小时。主线桥梁 3668 米/1 座(全幅),互通式立交 2 处,分别为三星互通式立交、西户互通式立交,预留 1 处沣泾互通式立交,涵洞 4 座,通道 6 道,收费站 1 处。

三星电子快速干道今年 10 月将实现建成通车。三星电子项目部承建架设的 K3+402 高架桥共 127 孔(762 片),从 2012 年 11 月 13 日开工架梁,项目部根据实际情况对移梁、运梁、架梁等各个工序都作了详尽安排,对工程中容易出现的问题事先做出详细分析并制定预案,实现了安全架梁零事故。

来源:西安晚报

## 为三星两研发中心提供定制人才服务

伴随着三星电子闪存芯片项目落户高新区,三星集团下属相关公司决定在高新区设立三星 SDS 西安全球开发交付中心(以下简称三星 SDS)以及西安三星电子研究所,开展各自业务。为了支持两个研发中心项目,人才服务中心于 5 月 12 日与 19 日,在绿地笔克国际会展中心举行了“2013 西安高新区重点招商项目企业(三星)专场招聘会”,专门为两个研发中心量身招募人才。两场招聘会期间,三星 SDS 及西安三星电子研究所共计提供职位需求人数超过 200 名,共吸引了超过 1500 名求职者前来应聘,其中不乏工作经验丰富,来自世界 500 强及国内知名软件通信企业的高端人才,招聘活动取得了良好效果。

据悉,三星 SDS 将结合本地人才优势和 SDS 全球化发展成功案例,把西安公司打造成为世界一流的研发中心。而西安三星电子研究所是三星电子全资海外研究所之一,预计将于今年 8 月成立,将主要从事智能手机、数字电视、半导体等领域的软件开发。

来源:开发区报道

## 三星项目 110 千伏变电站 6 月下旬正式带电投运

西安供电局昨日传来消息，三星项目 110 千伏专用变电站的电气设备目前已全部就位，上述专用变电站计划 6 月下旬正式带电投运。

为确保三星项目供电可靠，西安供电局主动作为、积极配合，从申请用电、图纸设计到设备及施工招标工作，仅用了 15 天就全部办理完毕。从去年 4 月至今，西安供电局举全局之力，十多个部门协调联动，使得上述工程顺利推进。

目前，三星项目 110 千伏专用变电站的电气设备已全部就位，各相关单位按照统一安排倒排工期，力争 5 月 31 日使架空线路具备验收条件，6 月 20 日之前电气一、二次设备进行验收，6 月 21 日三星项目专用变电站正式带电投运。

来源：西安晚报

## 三星西安项目将在西工大开展招聘并与学校联合培养人才

6 月 14 日，韩国三星电子专务、三星西安项目负责人金兴植一行到西工大访问，就三星西安项目在校开展招聘和联合培养人才等事宜，进行工作交流和沟通。据悉，该项目将在今年下半年正式进入学校开展招聘工作。校党委书记陈小筑，党委副书记、副校长王润孝，以及教务处、学生处、科技处等部门负责人，与金兴植一行亲切交流，商讨合作具体事宜。

王润孝表示，希望更多的西工大学生能够进入三星公司并成为骨干，学校也将根据该项目建设情况，进行人才“订单式培养”，以更好地符合企业要求。随后，教务处、学生处负责人分别就相关细节问题与项目有关代表进行座谈，在专业设置、技能要求、培养模式等方面达成初步共识。

据悉，三星西安项目将在 9 月份后进入学校展开招聘，并将与学校联合培养人才等。

来源：西安晚报

## 中国 IC 业：从设计到制造 均有能力竞争先进

中国 IC 业与国际水平存在技术鸿沟吗?存在多大差距, 是否可能弥补, 如何弥补? 这是当前 IC 界经常谈起的一个话题。然而, 中国 IC 业与国际先进水平之间真的存在无力追赶的技术鸿沟吗?如果仔细分析, 或会得出不一样的结论。

### 从设计到制造不存在技术鸿沟

IC 业大体可以分成 IC 设计、封测、代工制造、设备材料等几个环节, 就中国 IC 业与国际水平之间存在的差距, 我们可以逐一分析。

业界对于 IC 设计环节一直存在市场占有率“3+3+3+1”的说法, 它们分别代表着通用处理器(CPU)、存储器(Memory)、系统单芯片(SoC)以及功率器件等需要特殊工艺的集成电路。

SoC 是目前市场上变化最快、也最为活跃的部分。以 iPhone、iPad 为代表的移动智能终端的兴起, 促使相关 SoC 市场、技术快速成长。而在本土市场快速成长的带动下, 中国 IC 设计企业发挥贴近用户与快速抢市的优势, 形成了一套以客户为导向, 集中产品开发资源于先锋产品之上, 快速推出产品方案的战术。面对国际大厂的激烈竞争, 中国 IC 设计企业仍然能发挥主场优势, 获取市场份额, 保持成长。展讯、全智、瑞芯微电子等已在移动智能终端的低端市场站稳脚跟。之所以能够取得这些成绩, 根本原因是相关电子产品的生产主要在中国完成, 这就使得在国内进行相关 AP 的设计更具优势。

至于 IGBT、CMOS Imagesensor 等功率器件及其他采用特殊工艺的集成电路部分, 只要给时间, 中国企业也一定能够发展起来的。以前的相对弱势, 正是因为工业应用、汽车应用和医疗应用等类集成电路产品的终端应用行业还没有发展起来造成的。但随着未来中国产业升级, 中国在上述领域的市场需求将越来越大。正像消费电子市场带动上游 SoC 一样, 只要假以时日, 特殊工艺集成电路产业也能发展起来。

Memory 部分的产业格局更具独占性, 韩企在这一领域拥有统治地位。这个部分产品对工艺的要求也比较高, 中国企业不是没有涉及, 比如兆易创新就在开发生产 NOR 闪存, 至于突破 NAND 还需要等待。

通用处理器向来是中国的弱项。由于该项产品的社会认知度较高, 一提到中国 IC 产业的不足, 普通消费者往往会拿通用处理器来说事儿。此前中国在这一领域也投入了巨大精力, 效果却不尽如人意。然而, 现在通用处理器的产业结构正在发生变化, 移动设备的兴起取代了以往 PC 的主导地位, Wintel 联盟打破, Win8 开始支持 ARM, X86 架构的市场越来越小, ARM 架构开始占有优势。这给中国企业以发展的契机, 不

需要再纠缠于 X86, 采用 ARM 架构, 可以拥有自己的芯片。

谈到起中国的半导体制造, 就免不了要谈到中芯国际。2000 年中芯国际和宏力的奠基是中国民间资本进入半导体制造行业的开始。经过十余年的发展, 其间不免坎坷, 但是目前中芯国际已经形成自身工艺的研发能力, 可以追赶世界先进工艺, 从建厂时候的  $0.25\ \mu\text{m}$  工艺, 到现在可以量产 40nm, 正在研发 28nm 工艺; 形成自身的扩产能力, 从开始的一家 8 英寸厂, 发展到现在的 3 家 8 英寸厂, 2 家 12 英寸厂, 产能翻了 7~8 倍; 形成了客户的多元化, 从开始阶段的以海外客户为主, 国内客户小于 10%, 到现在国内客户接近 40%。

此前, 中芯国际出现问题关键在于管理, 业内流传着这样一句话“没有张汝京, 就没有 SMIC; 有了张汝京, 就没有赢利的 SMIC”。张汝京讲究规模扩张, 不注重企业的赢利能力; 同时研发严重推迟, 同国际差距越来越大。2011 年 6 月, 张文义成为中芯国际的董事长, 邱慈云为 CEO, 在不到两年的时间里面, 公司已经取得良好发展。

至于封装测试领域, 国内的长电、南通富士通等企业的水平已经接近世界先进水平, 能够满足国际、国内市场的大部分需求。在这个领域, 中国企业毫无悬念可以达到世界先进水平。

甚至在设备和材料领域, 过去 10 年里, 中国企业也有所布局, 包括刻蚀机、清洗设备、扩散炉以及光刻机等, 但是这些设备只是初步达到可商用水平, 多数尚未真正进入市场。不过, 设备和材料公司的客户是制造商, 随着中国制造企业的走强, 未来也将逐渐扭转设备材料领域的弱势格局。

总之, 中国 IC 业不同环节的发展程度各不相同, 有的已经达到可与国际大公司一较高下的地步, 有的还需潜心发展, 但是至少技术鸿沟是不存在的, 中国 IC 企业完全有能力参与国际竞争。

### 从国营到民营 IC 全新发展

上个世纪八九十年代, 中国半导体产业以国营体制为主。当时企业的最大问题就是脱离国际潮流、脱离市场。在此背景下, 我国在“八五”和“九五”期间分别实施了“908”工程和“909”工程两项旨在推进微电子产业发展的重点工程。1990 年 8 月, “908”工程启动; 1995 年开始建设 6 英寸生产线; 1998 年 1 月, “908”工程华晶项目通过对外合同验收。该项目的建成投产使国内集成电路生产技术水平由  $2\ \mu\text{m}\sim 3\ \mu\text{m}$  提高到  $0.8\ \mu\text{m}\sim 1\ \mu\text{m}$ 。但由于审批时间过长, 工程从开始立项到真正投产历时 7 年之久, 因此建成投产时技术水平已落后于国际主流技术 4~5 代。1995 年 12 月, 国务院总理办公会议正式决策实施“909”工程, 投资 100 亿元建设一条 8 英寸、 $0.5\ \mu\text{m}$  的芯片生产线以及 8 英寸硅单晶生产和若干个集成电路设计公司。1999 年 2 月华虹 NEC 生产线

建成投产，技术档次达到  $0.35\ \mu\text{m}\sim 0.24\ \mu\text{m}$ 。

回头看两项工程可以总结出几点经验教训：一是 IC 技术和市场变化太快，国有甚至合资体制很难适应 IC 业这种快速变化的市场环境。二是只投资建设一家孤立的工厂，并没有形成一条完善的产业链，而完善的产业链环境又是 IC 业发展所必须的。三是建成的企业缺乏市场开拓能力，仅靠国家提供的市场机会，难以做大。比如当年的几家设计公司通过交通卡、电话卡起家，后来又借助二代身份证，初期的垄断市场使企业过上好日子。可是一旦真正进入全面市场竞争阶段，就难以适应了。以至行业内有“成也身份证，败也身份证”之说。

回顾以国家投入为主的我国 IC 产业发展阶段，总体说并不是很成功。这是因为中国的 IC 产业面对的是全球市场、国际化竞争，靠国家投资、内部购买是没有前途的。

因此，只有改变以国有体制为主体的发展模式，走国际化、市场化道路才能真正做好中国 IC 业。而目前发展相对良好的中国 IC 业，正是 2000 年前后逐渐建立完善起来的、以民营企业为主体的产业群。它们虽然与以前国有体制为主体的半导体行业存在一定历史渊源，但是在市场开拓、运营管理、技术创新的方式方法上都有着巨大的不同。

### 从扶持到调控市场环境重要

未来，中国 IC 业要想取得良性发展，缩小与国际水平的差距，几条措施十分关键：一是对于 IC 设计、封装等产业来说，国家应当调控市场，提供良好的市场环境，优胜劣汰，公平竞争；二是通过“863”等重大专项，以项目的方式支持由龙头企业牵头的研发，扶大扶强龙头企业；三是对于先进产能的扩充，应当通过国家资金给予支持。最重要的两个方向就是逻辑先进工艺和存储器。

国家对于先进产能的投资则需要满足如下条件：一是资金的引入不能影响该公司原来的独立性和国际化；二是资金引入应该以市场化的方式引入，保持国家资金、地方政府配套、社会资本投入为 1:2:3 的比例；三是社会资本的引入十分重要，它可以引入市场化的制约机制，促进公司形成明确的长期发展目标，同时也会强调自身的造血功能，可以使企业自身独立滚动发展；四是可以设立“产业基金”的模式保证上述几点得到落实，产业基金独立运营，引进专业人士管理，避免多头管理；五是今后一段时间，可以通过政策鼓励的方式，支持中国 IC 企业进入非消费类电子产品领域，比如汽车、工业、高铁、医疗等长期看好的市场。

来源:华强电子网

## 韩国三星率先研发成功第五代移动通信核心技术

韩国三星电子 5 月 12 日对外公布, 该公司成功研发 5G (Fifth Generation, 第五代移动通信技术) 环境下的数据收发核心技术, 这在全球范围内尚属首例, 率先开创了新一代移动通信技术的新局面。

数据显示, 5G 通信下手机的无线下载速度最快可达每秒 3.6Gbps (千兆, 数据传输速度单位, 1Gbps=1024Mbps), 较 LTE (泛称准 4G) 的 75Mbps (兆) 快数百倍。截至目前, 世界上最快的无线通讯技术仍由三星公司研发。

为解决移动通信频率资源的短缺问题, 并进一步提升数据传输速度, 5G 通信环境所要求的带宽较目前要大。但由于超高频带宽波长过短, 数据传输过程中掉包现象严重, 以及传输距离过短, 因此一直以来世界各地通信公司仍无成功先例。

三星电子表示将在 2020 年前实现 5G 通信的商用化, 预计与 5G 相关的国际通信标准及服务也将在韩国率先问世。

预测到 2017 年, LTE 用户将达 9 亿人, 到 2018 年上半年将突破 10 亿人大关。手机终端用户在选择通信服务时倾向于“高速消费”, 尤其是在通信网络革新频率最高的韩国, 这无疑为打造 5G 通信环境奠定了“基数效应”。来源: 科技部

## 触控 IC 战局: 三大阵营囊括六成市场

根据 DIGITIMES 观察, 全球智能手机、平板电脑市场成长力道强劲, 大陆及新兴市场掀起一波换机潮, 国内、外芯片大厂为争取庞大商机, 不仅推升移动设备主芯片迈向双核、4 核、甚至 8 核的升级战, 更引爆触控 IC 芯片市场争夺大战, 英特尔(Intel) 藉由大动作投资敦泰、禾瑞亚, 联发科采取合并晨星及转投资汇顶科技, 加上在专利战上技术性击倒苹果(Apple)的义隆电, 三大芯片阵营顺利抢占全球触控 IC 逾 6 成版图, 包括高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)及德州仪器(TI)等国际芯片大厂则在后面苦追。

芯片业者指出, 触控 IC 应用横跨消费性电子、PC 及通讯、甚至是汽车电子领域, 近年来全球触控 IC 市场规模的年复合成长率均逾 20%, 在庞大市场商机考量下, 自 2008 年起有意切入全球触控 IC 市场的国内、外芯片供应商超过 50 家, 光是台厂投入触控 IC 应用研发的 IC 设计业者便多达 20 家以上。

由于触控 IC 商机诱人, 不仅小型 IC 设计业者投身全球触控 IC 市场, 就连英特尔、联发科、高通、博通及德仪等芯片大厂亦纷加入战局, 不过, 不少国内、外一线芯片大厂因内部研发资源有限, 无法全力投入触控 IC 产品研发, 但在肥水不落外人田的考

量下，纷透过转投资动作布局触控 IC 中、长线市场商机。

联发科原本有意投资敦泰，但未被敦泰接受，后来再找上汇顶投资入股，接着在 2012 年决定合并晨星，联发科在并入单月触控 IC 出货量已逾 300 万颗的晨星后，目前联发科集团单月触控 IC 出货量突破 1,000 万颗大关，与敦泰出货规模并驾齐驱。

来源:国际电子商情

## 台积电 28 奈米遇袭 格罗方德获瑞芯微订单

台积电 (2330) 28 奈米订单再遭对手抢食。Globalfoundries (格罗方德) 6 月 18 日表示，中国瑞芯微电子的新一代行动处理器将开始量产，并采用格罗方德 28 奈米高介电金属闸极 (HKMG) 制程技术，代表台积电在 28 奈米上制程已有对手开始挑战霸主地位，引发市场关注。

中国瑞芯微去年底宣布推出 4 核心行动处理器，号称是中国第 2 颗采用 28 奈米制程的处理器产品，旗下 RK3188 产品也于去年底对外透露晶圆代工厂为台积电，不料，今旗下包括 RK3188、RK3168 也交由格罗方德以 28 奈米制程量产中。

台积电法人则指出，虽然无晶圆厂或晶片设计业者选择 2 家以上代工厂是很正常的事，但台积电短期内独霸 28 奈米制程地位不会动摇。

另外，台积电在太阳能领域发展则传出好消息，台积太阳能公司昨日宣布台中先进厂房以现有的制造设备与材料，成功生产出商用规格 (1.09 平方米) 的 CIGS (铜铟镓硒) 冠军模组，其转换效率高达 15.7%，此转换效率也通过 TUVSUD 的见证及确认，取代台积太阳能今年元月创下的 15.1% 转换效率的世界纪录。

来源:苹果日报

## 联电宣布与 IBM 共同开发 10 奈米 CMOS 制程

6 月 13 日，晶圆代工大厂联电 (UMC) 与 IBM 共同宣布，联电将加入 IBM 技术开发联盟，共同开发 10 奈米 CMOS 制程技术。联电与 IBM 两家公司此次的协议，拓展了双方于 2012 年签订之 14 奈米 FinFET 合作协议。

拥有 IBM 的支援与 know-how，联电将可持续提升其内部自行研发的 14 奈米 FinFET 技术，针对行动运算与通讯产品，提供富竞争力的低耗电优化技术。双方计划开发 10 奈米制程基础技术，以满足联电客户的需求。联电将指派工程团队加入位于美国纽约州阿尔巴尼 (Albany, New York) 的 10 奈米研发计划，而联电 14 奈米 FinFET 与 10 奈米未来的制造，则将于该公司位在台湾南科的研发中心进行。

IBM 半导体研发副总 Gary Patton 表示：“IBM 联盟成立至今已逾十年，联盟夥伴可整合运用我们的专业知识，团队研究合作与创新的技术研发，藉此满足对先进半导体应用产品与日俱增的需求。联华电子的加入，将使联盟的实力更加强大。”

联电执行长颜博文表示：“IBM 为众所公认的半导体技术领导者。联华电子十分高兴与 IBM 在先进制程领域携手合作，贡献我们多年来开发高竞争力制造技术所累积的经验。身为世界顶尖的晶圆专工厂之一，联华电子肩负着适时推出尖端制程，以实现客户次世代晶片设计的使命与承诺。我们期待与 IBM 密切合作，借重其深厚的技术专业来缩短我们 10 奈米与 FinFET 的研发周期，为联华电子与我们的客户缔造双赢。”

来源:eettaiwan

## Gartner：2013 年全球半导体制造设备支出将下滑 5.5%

2013 年 6 月 20 日，中国北京—全球技术研究和咨询公司 Gartner 指出，2013 年全球半导体资本设备支出将达到 358 亿美元，与 2012 年 378 亿美元的支出相比，下滑 5.5%。Gartner 表示，由于主要厂商面对市场疲软的态势仍持谨慎态度，2013 年，资本支出将下滑 3.5%。

Gartner 研究副总裁 Bob Johnson 表示：“半导体市场的疲软持续到今年第一季度，导致对新设备的购买带来下行压力。然而，半导体设备季度性收入开始提升，而订单交货比率的乐观迹象表明设备支出将于今年晚些时候回暖。展望 2013 年以后，我们预计目前经济萎靡将贯穿整个行业，而所有细分领域的支出将在预测期余下的时间内遵循普遍增长的模式。”

Gartner 预测 2014 年半导体资本支出将增长 14.2%，2015 年将增长 10.1%。下一个周期性下滑较温和，2016 年预计下滑 3.5%，随后在 2017 年将恢复增长。

尽管所有产品的资本支出都在 2013 年呈下降态势，逻辑支出将是表现最佳的领域，与总体市场 3.5% 的下滑相比，逻辑支出仅下滑 2%。这是由少数几个顶级厂商积极投资所推动的，这些厂商在亚 30 纳米节点上增加了产量。2013 全年，内存将持续疲软，DRAM 维护级投资和 NAND 市场的小幅下跌直到供需平衡后才能回暖。2014 年，Gartner 预计资本支出恢复增长，比 2013 年将增长 14.2%。代工领域支出在今年将增长 14.3%，而集成器件制造商（IDMs）和半导体装配和测试服务（SATS）供应商的支出将下滑。2013 年以后，内存在 2014 和 2015 年将迅猛增长，随后在 2016 年进入一个周期性下滑，而逻辑将恢复稳步增长的格局。

由于主要厂商已经走出高库存和半导体市场普遍疲软的阶段，2013 年全球晶圆代工工厂设备（WFE）出现连续的季度环比增长。今年初，订单交货比率在几个月内首次通过 1:1。该迹象表明随着对领先设备需求的提升，对新设备的需求也正在提升。2013 年以后，Gartner 公司认为 WFE 市场在 2014 和 2015 年将恢复到两位数增长，在 2016 年进入温和的周期性下滑。

来源:Gartner

## 美国能源部将资助 LED 及 OLED 照明研究项目

2013年6月4日,美国能源部长 Ernest Moniz 宣布将资助五个制造研究和发展项目,以资助高效照明产品。这些项目将致力于在持续提升 LED 和 OLED 产品的质量和性能的同时,降低制造成本。今日,LED 照明产品的光效已经达到传统照明的 6-7 倍,最多可以达到 25 倍之多。能源部计划投资 1000 万美金以支持相关企业的研发活动。Ernest Moniz 提到,通过资助工业界的相关研发活动,高效照明将节省消费者更多的能源和创造更多的就业机会。这也就是能效研发给经济带来的双赢作用。

根据美国能源部的最新报告,美国近两年的 LED 灯具已经增加超过 10 倍,从 2010 年的 450 万个单元到 2012 年的 4900 万个单元。这些安装在室内或室外的 LED 照明产品,如嵌灯或路灯,预计每年给消费者节省 6 亿 7500 万美元的能源费用。同时,LED 替换灯泡的费用下降了 54%。在今后的二十年将现有光源全部替换为 LED 灯泡,将在照明领域降低近 50% 的能源消耗,节省 2500 亿美元的能源费用。到 2030 年,LED 将占到整个照明市场的 75%,节约的电能可以供 2600 万户美国家庭使用。

不过,尽管生命周期成本看起来非常有吸引力,但是 LED 和 OLED 等初装费用远高于传统照明,能源部希望通过资助的项目,在提供照明质量和性能的同时,有助于在生产设备和过程中显著降低成本。能源部资助的相关 LED 和 OLED 项目将致力于 LED 灯的模块化设计、LED 灯具的散热、OLED 的印制等关键技术的研发,降低 LED 灯具的成本,使得 LED 和 OLED 灯具能够更多地走进普通消费家庭。

来源:LED 在线

## 飞利浦将加大 LED 照明投入

飞利浦于 6 月 9 日携带参展历年来的最强阵容亮相广州国际照明展览会,随着中国被定义为“本土市场”,中国在飞利浦全球战略版图上的地位日益提升。展会上,飞利浦表示,将继续加大在中国 LED 照明市场的投入和支持。

根据飞利浦 2013 年第一季度财报显示,LED 照明产品及解决方案的销售额同比增长 38%,占照明事业部总销售额的 23%。此外,为实现在 2015 年 LED 业务占整体业务量的 50% 这一目标,飞利浦照明正持续投入,在中国打造以客户为中心,从市场研究、设计开发、采购制造到市场营销的“端到端”客户价值链;并加快实现从照明产品部件生产商,向整合照明解决方案提供商的战略转型。

来源:LED 在线

## 三安光电与美国巨头分道扬镳 拟独做光伏电站

三安光电 6 月 25 日发布董事会公告称, 公司拟以 480 万美元受让 EMCORE Corporation 持有的日芯光伏科技有限公司(下称“日芯光伏”)40% 股权, 受让完成后, 公司将持有日芯光伏 100% 股权。换言之, 公司与美国 EMCORE Corporation 合作近三年后终于宣布分手。

对于合资双方为何分手? 公司相关负责人表示, 在与 EMCORE Corporation 三年合作中, 公司在光伏电站、发电模组研制开发, 以及光伏发电系统工程设计建设等方面都有了很大提高, 只是由于双方都是上市公司, 所处的政策法规环境和投融资审批程序等方面差异较大, 故双方同意结束合资, 由公司受让对方股权, 但双方在光伏业务和技术开发方面的合作还将持续。

资料显示, 2010 年 8 月, 该公司公告与美国 EMCORE Corporation 签署《合资合同》, 注册资本 3000 万美元, (后增资到 6700 万美元), 其中, 三安光电和 EMCORE 分别出资 1800 万美元和 1200 万美元, 分别占合资公司注册资本的 60% 和 40%。

来源: 上海证券报

## TenKsolar 推出多晶硅光伏系统 解决屋顶太阳能缺陷

位于美国 Bloomington 的太阳能元件制造商 TenKsolar 宣布, 全面推出的多晶硅 410W “RAIS XT” 光伏系统, 拥有业界领先的质保、性能和能源成本。

tenK 创始人兼首席技术官达拉斯·迈尔(Dallas Meyer)表示: “我们一直致力于解决商业规模屋顶太阳能的各个缺陷。每个屋顶比标准屋顶太阳能系统多产生高达 44% 的能源, 该 RAIS XT 提供无与伦比的价值和性能。”

RAIS XT 基于 tenK 的电池优化光伏(PV)架构, 消除了常规太阳能组件串联的固有局限性。迈尔表示: “失效模式及常规太阳能组件的风险包括热点、电势诱发衰减以及高压电弧, 这些不可能存在于 tenK 技术。鉴于我们新发布的能源生产研究, 数据清楚地支持了 tenK 的优势。”

tenKsolar 日前发布了一份长期能源生产调查, 针对全美安装 RAIS 光伏系统的地点, 证明在相同地点较常规太阳能电池阵, 每额定功率多产生能源 25% 至 30% 以上。此外, 由于电池在组件中的独立性, tenK 提供世界级可靠性优势。RAIS XT 在第一年后, 直至二十五年内, 为领先的买家保护提供业内最佳质保, 确保每年的性能衰减不大于 0.2%。

tenKsolar 首席执行官 Joel Cannon 表示: “有了 RAIS XT, 我们以最具竞争力的能源成本交付业内领先的性能、安全性以及能源密度。很明显, 欧洲、中美洲以及美国各地已经出货系统并预定订单。”

来源: PV-Tech

## 英特尔设1亿美元基金投资感知技术

北京时间6月5日凌晨消息,据美国科技博客 VentureBeat 报道,英特尔公司旗下投资部门英特尔资本(IntelCapital)设立1亿美元基金,用于投资感知类运算技术,例如通过3D深度摄像头(3Ddepthcamera)追踪用户手势的识别技术等。英特尔资本主要的投资对象是新一代技术,旨在扩大英特尔芯片的市场需求。感知类技术包括眼球追踪、语音识别、面部识别及手势控制等。此次投资目的在于振兴受平板电脑影响的PC市场。

英特尔表示,该基金将在未来2、3年内,着重投资触控应用、成像、手势及语音控制、情绪传感及生物识别等技术。英特尔执行副总裁兼英特尔资本总裁苏爱文(ArvindSodhani)表示:“这类技术以前只会出现在科幻电影中。如今,随着计算机及摄像头技术的发展,感知技术能够真正走进人们的生活。我们设立这支基金,是为了资助在该领域进行研发的公司,帮助他们拓展业务。”

英特尔去年就已在开发者大会上发布感知类技术的提案,并且举办了一场感知类应用程序大赛。自去年起,其感知类技术 SDK 下载量已突破1万次。

此外,英特尔在还发布了一款名为 CreativeSenz3D 的传感摄像头,预计将在今年第三季度上市。同时,该公司还宣布,明年下半年将在配置英特尔处理器的设备上集成3D深度摄像头技术。数年前,英特尔设立3亿美元的超级本基金(UltrabookFund),支持研发超级本。自1991年起,英特尔资本已陆续向54个国家的1284家公司共计投资108亿美元。

来源:新浪科技

## 中国2012年物联网规模达3650亿

近日在国家金卡工程应用成果报告会上,相关负责人透露,2012年我国物联网市场规模达到3650亿,RFID(电子标签识别)市场规模达到236.6亿元人民币,比上年增长了31.7%。其中,RFID市场规模位居世界第3。

4120万部全球LTE手机出货量达4120万部

来自市场研究公司 StrategyAnalytics 的最新数据显示,2013年第一季度,全球LTE手机出货量达4120万部,较去年同期的790万部实现大幅增长。此前 StrategyAnalytics 预测,2013年LTE全球智能手机出货量将是2012年的3倍。2012年LTE4G智能手机出货量为9090万部,2013年这个数字将增至2.75亿部。

4G终端发展迅猛,起带动作用的,是LTE网络建设的加速推进。自全球首个LTE网络于2009年底开始商用以来,LTE全球市场突飞猛进。据GSA统计,至2013年4月,LTE已在全球67个国家得到商用,网络数量达163个。根据 StrategyAnalytics 的数据,至2012年底LTE网络已覆盖全球人口的11%,而在2013年内,这一数字将再翻一番至22%。

来源:中国新闻网

## 智慧城市第二批试点有望获得 800 亿的贷款

6 月 17 日, 在由深圳市经贸信息委主办的 2013 年全国节能宣传高峰论坛上, 中国智慧城市研究院的工作人员透露, 国家开发银行针对第二批开放的 50 多家智慧城市试点城市, 计划提供 800 亿的贷款。此次论坛共有全国 10 家省级和 44 家市级的驻深招商办参与。

关于智慧城市:智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新(创新 2.0)环境下的城市形态。智慧城市基于物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法的应用, 营造有利于创新涌现的生态, 实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。

来源:中国信息产业网

## Gartner: 2013 年全球移动支付交易额将成长 44%

顾能(Gartner)表示, 2013 年全球移动支付交易额将达 2354 亿美元, 较去年 1631 亿美元成长 44%。全球移动支付使用人数也将从去年 2 亿 80 万人增至 2 亿 4520 万人。顾能研究总监沈哲怡表示, 预期 2012 年到 2017 年间, 全球移动交易量与交易额将以平均每年 35% 的幅度成长。此外, 至 2017 年, 移动支付总市值预测将达 7210 亿美元, 总使用人数将逾 4 亿 5000 万人。

顾能指出, 2012 年近距离无线通讯(Near Field Communications, NFC)技术在各地市场采用程度不理想, 且 Google 钱包、Isis 移动支付系统等高阶服务市场吸引力也不佳。因此顾能进一步调降 2012 年到 2017 年间的 NFC 交易额预测逾 4 成。尽管随着 NFC 手机的普及与非接触式感应器(contactless reader)增加, NFC 占总交易额的比重可望自 2016 年有所成长。但顾能预测, NFC 占总交易额的比重, 2013 年将仅有 2%, 2017 年则为 5%。

顾能预估, 2013 年金融转帐和商品购买分别占总交易额的 71% 和 21%, 是移动支付的主要项目。由于服务范围扩展, 且手续费较传统银行收取的金额低, 使用者转帐的频率将与日俱增, 预估到 2017 年, 金融转帐仍占移动支付交易的大宗, 占总移动支付交易额的 69%。

故能预测, 北美地区交易额 2013 年预期成长 53%, 来到 370 亿美元; 而亚太地区的交易额 2013 年将成长 38%, 达到 740 亿美元, 主要动能来自南韩、新加坡等已开发市场, 以及印度等开发中市场。2016 年亚太地区将超越非洲的 1600 亿美元, 成为交易额最高的地区。

来源:物联网世界

## 瑞芯微发布基于 28nm 新款平板电脑芯片

6月18日, GlobalFoundries 与福州瑞芯微电子有限公司 18日共同宣布, 瑞芯新一代基于 GlobalFoundries 28 纳米高 K 金属栅 (HKMG) 工艺技术的移动处理器已进入量产阶段。RK3188 与 RK3168 芯片基于 ARM 多核 Cortex-A9 技术设计和优化, 主要用于未来高性能、低成本且具有长时间续航能力的平板电脑。

全新的用于主流平板电脑的系统级芯片 (SoC) 整合了瑞芯的设计与 GlobalFoundries 28 纳米 HKMG 工艺技术, 最高运行频率可达 1.8GHz, 却仍然保证了移动设备用户所期望的功效。RK3188 与 RK3168 已于 2013 年初即开始为 OEM 提供样品, 现已投入大规模量产。

GlobalFoundries 28 纳米 SLP 技术是下一代智能移动设备的理想选择, 它能够令设计拥有更快的运行速度、更小的产品尺寸、更低的待机功耗与更长的电池寿命。这项基于 GLOBALFOUNDRIES 前栅极 (GateFirst) HKMG 工艺的技术已经投入量产超过两年时间。它集高性能、低能耗与低成本于一体, 是价格敏感的主流移动设备市场的理想之选。

来源:新华网

## AMD 发布用于台式电脑的 32nm 工艺 4.4GHz 四核 SoC

AMD 公司在 2013 台北国际电脑展上正式发布了一款面向台式电脑的 MPU/GPU 整合型处理器 (APU) 新产品——“2013AMDEliteA-SeriesDesktopAPU” (开发代码: Richland)。该产品实现了 4.4GHz 的最高工作频率, 是台式电脑用处理器的业界最高速度。现已开始量产, 配备该处理器的个人电脑预定 2013 年 6 月内上市。

Richland 配备 4 个高速版 x86 架构 CPU 内核 “Piledriver”、6 个 GPU 内核, 集成的晶体管数量为 13 亿, 利用 32nm 工艺 SOI 技术制造, 共有 4 款产品。热设计功耗 (TDP) 方面, “A10-6800K” (最高工作频率为 4.4GHz) 和 “A8-6600K” (最高工作频率为 4.3GHz) 为 100W, “A10-6700” (最高工作频率为 4.2GHz) 和 “A8-6500” (最高工作频率为 4.1GHz) 为 65W。与该公司的原产品相比, 多线程性能最大提高 9%, 图形处理性能最大提高 15%。此外, 还采用了基于片上温度传感器的频率/电压动态控制技术——Temperature Smart Turbo Core Technology。

来源:技术在线

## 联发科 Q4 推 4G 芯片 MT6290, 可支持中移动

联发科(2454)拟下半年推出 4G 芯片 MT6290, 可支持中国移动的 4G-LTE 网络, 可望成为中国 4G 山寨机的标准配备, 预估 12 月开始出货, 最快明年 1 月获中国一线大厂推出搭载此款芯片手机。

联发科今日股价表现逆势较大盘抗跌, 盘中由黑翻红, 一度急拉涨近 4%。

董事长蔡明介于日前股东大会上即表示, 第 4 季联发科将推出 4GLTE 解决方案, 与对手技术差距则缩短仅有 1-2 年, 代表联发科持续缩短与对手差距, 同时他也看好该解决方案将成为重要成长动能。

据了解, 联发科可支持 4G 处理器 MTK6290 芯片, 将采用 28 纳米 A7 架构, 性能估与四核心芯片 MT6589 相差不大, 预估将在 12 月开始出货, 最快明年 1 月就可看到中国一线厂包括中兴、华为、联想等推出搭载此款芯片的手机。

来源:工商时报

## 首个硅衬底绿黄氮半导体 LED 研发成功

香港科技大学(HKUST)近日研发出一种高性能的硅衬底绿黄氮半导体 LED, 此项新研究成果发表在 IEEE Electronic Device Letters 上(5 月 29 日)。研究人员称其 565nm 黄色 LED 是第一款硅衬底多量子阱(MQW)设备。

在 2 英寸硅片上, 研究人员使用金属有机气相沉积(MOCVD)技术来生成最初的模板, 该模板由氮化铝(AlN)成核、8 对氮化铝/氮化镓(AlN/GaN)层组成, 以创造出一个超晶格(SL)(用作应力平衡夹层)和一个  $2\ \mu\text{m}$  GaN 缓冲层。研究人员首先对 SiO<sub>2</sub> 层和铟锡氧化物(ITO)层进行沉淀, 再利用氯化氢(HCl)酸溶液对 ITO 进行蚀刻, 最后使用等离子蚀刻法来形成二氧化硅(SiO<sub>2</sub>)纳米棒。随后, 通过 MOCVD 技术生成 LED 结构, 在纳米棒、AlN/GaN SL 夹层、 $2\ \mu\text{m}$  n 型 GaN、5 周期多量子阱(MQW)以及 200nm 的 p-GaN 周围再生成 800nm GaN。再生成的 GaN 位错密度为  $8 \times 10^8/\text{cm}^2$ , 被称为“最低的硅衬底 GaN 位错密度之一”。最后, 准备适用于发射黄色(565nm)和绿色(505 和 530nm)光的材料, 以制作  $300\ \mu\text{m} \times 300\ \mu\text{m}$  LED 芯片。如预期一样, 随着波长增加, 光输出功率(LOP)逐渐下降。在 20mA 条件下, 505nm 波长的输出功率为 1.18mW, 530nm 和 565nm 波长的输出功率分别为 0.30mW 和  $74\ \mu\text{W}$ 。对于 505nm、530nm 和 565nm 设备, 光输出功率分别在 7.60mW(200mA)、2.72mW(180mA)和 0.52mW(160mA)条件下达到饱和状态。

据称, 这是人们首次在硅衬底上成功制造出 565nm 黄色 InGaN/GaN MQWLED, 且 505nm LED 的 LOP 远远高于以往的硅 LED 设备。除了提高材料质量外, 该机构研究人员相信纳米棒也可以增强光提取散射效应。

来源:LED 在线

## 杭州晶华微电子推出内置温度补偿的实时时钟芯片

杭州晶华微电子(SDIC)最近推出带温度补偿的实时时钟芯片 SD3025TE。该芯片功耗低,RTC 工作时功耗只有 0.6uA;时钟精度高,在-40℃~85℃范围内最大误差 $\pm 5$ ppm。

SD3025TE 内置高稳定性 32.768kHz 晶振,内置高精度温度测量电路,对晶振进行温度补偿。12 位温度检测结果可以被用户读出使用,精度小于 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。可以计算年、月、星期、日期、时、分、秒,可以自动进行闰年计算(2000 年~2099 年)。管脚兼容 RX8025T。

SD3025TE 封装形式是 SOP14,自带电源切换电路,根据电池电压和交流稳压电源的大小自动切换,减少外围电路。

来源:国际电子商情

## 英飞凌针对高速车载通信推出 FlexRay 收发器

2013 年 6 月 25 日,英飞凌科技股份有限公司推出其首个 FlexRay™收发器,进一步壮大了 LIN 和 CAN 汽车通信 IC 产品阵容。全新的 TLE9221SX 完全符合最新的 FlexRay 电气物理层规范 3.0.1 版本。它可针对车载通信实现高达 10Mb/s 的数据速率,并具备  $\pm 10\text{kV}$  的一流 ESD 防护性能。作为通信控制器单元和总线线路之间的接口,TLE9221SX 收发器适用于悬架和底盘控制应用以及电动助力转向、发动机和变速箱控制单元。

“当前的一个显著发展趋势是,FlexRay 总线由底盘控制和车身网关应用扩展至动力系领域,包括发动机和变速箱控制。”英飞凌科技股份有限公司副总裁兼汽车电子部标准电源事业部总经理 FrankSchwertlein 指出,“英飞凌推出的完全通过认证的 FlexRay 收发器,具备极高的鲁棒性和一流的 ESD 防护性能,能够处理高达 10Mb/s 的数据传输速率,顺应了这一市场发展趋势。”

FlexRay 收发器 TLE9221SX 现已开始量产。这些器件采用符合 RoHS 标准的 PG-SSOP-16 封装。采用 14 引脚 PG-TSSOP 封装的型号计划于 2014 年年底开始供货。

来源:中国半导体行业信息网

## 关于 2013 年集成电路设计企业认定和年审的通知

各集成电路设计企业：

根据“国发[2011]4 号”、“财税[2012]27 号”文件规定，现将 2013 年集成电路设计企业认定和年审工作的事项通知如下：

1、中国半导体行业协会从发文之日开始 2013 年度的集成电路设计企业认定和年审工作。凡申报 2013 年度“集成电路设计企业”认定和年审的企业，上报材料的截止日期为 2013 年 8 月 30 日。

2、要进行 2013 年的企业年度审查的企业为：“关于印发《集成电路设计企业名单（第十批）的通知》，工信部电子[2012]593 号，”批准的 70 家企业和“关于印发《2011 年度通过的集成电路设计企业名单》的通知，工信部电子[2012]592 号”批准的 367 家企业。

特此通知。

二〇一三年六月六日

详情请登录 IC 中心网站：<http://xaic.com.cn/allarticle/shownews.asp?id=11261&cate=1>

## 关于 2013 年度西安市技术先进型服务企业复审结果公示的通知

各有关单位：

根据《西安市技术先进型服务企业认定管理办法》，6 月 8 日，西安市科技局会同西安市财政局、西安市商务局、西安市国税局、西安市地税局、西安市发改委组织相关专家，对 2009 年已通过技术先进型服务企业认定的 15 家企业进行了复审认定。综合专家意见，拟同意“新蛋信息技术（西安）有限公司”等 10 家企业通过复审认定，现予以公示。公示时间 2013 年 6 月 9 日至 6 月 26 日。

公示电话：86786639。

西安市科学技术局

2013 年 6 月 9 日

详情请登录科技局网站：

<http://www.xainfo.gov.cn/admin/class.asp?id=12143&text=%BF%C6%BC%BC%BE%D6%B9%AB%B8%E6>